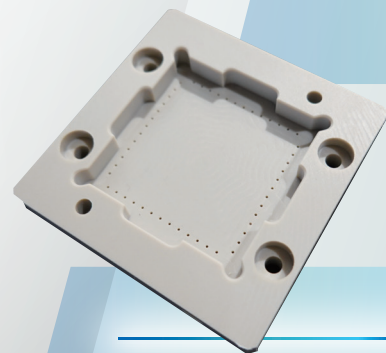


Solution Fair 2026

5軸 & 半導体

スペシャル

2026.7.15水-16木10:00-16:00
ブラザーテクノロジーセンター刈谷事前
申し込み制ご来場の際は、下記の
「来場申し込み」から
来場登録をお願い
いたします。

30番5軸加工

30番5軸加工の新しいステージを体感！

ø680mmの治具エリアを有したHU550Xd1による大物加工。今春ついに登場したU500Xd2
高トルク仕様によるS50Cの5軸割出加工ではø32mmフライス(プランジ加工)も実演。

他にも同時5軸、5軸+旋削加工などSPEEDIOならではのさまざまな加工ソリューションを提案いたします。

半導体関連

半導体製造装置のワークのデモ加工や展示、

脆性材：セラミック、難削材：インコネルなどの加工を実演します。

他にもSPEEDIOで加工したSiCのワークも紹介。

コラボメーカー

多数出展し、5軸加工や半導体関連のソリューションを展示します。

※展示内容は変更となる可能性があります

セミナー

事前予約制

※下記の「来場申し込み」よりご登録ください。
席に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

- 30番5軸による加工のコツ
- 半導体関連ソリューションのご紹介
- コラボメーカーセミナー

7/15 セミナー

午前 10:30-11:30 午後 13:30-14:30

7/16 講演 + セミナー

午前 10:30-11:45 午後 13:30-14:45

※各日とも午前・午後は同内容です。

講演

16日のみ
開催2026年の半導体産業は
150兆円の巨大市場に成長する!!

設備投資も活発化し、装置と材料に大きなインパクト

日時 16日のみ午前・午後
各1回開催講師 産業タイムズ社
会長 泉谷 涉様現在の半導体産業の潮流と、あわせて、半導体の加工現場の
今をご紹介します。

予約制

来場
申し込み

右記QRコードよりお申し込みください。

申し込み期限: **7月13日(月)**

※昼食の申し込みも可能です。

昼食をご希望の場合:

申し込み期限 7月9日(木)まで



